



サーマルブリッジテクノロジー 入出力 (I/O) アプリケーション

利点

- 2倍優れた熱抵抗
- より良い信頼性および耐久性
- 向上したアプリケーション可用性

アプリケーション

- ハイパフォーマンスコンピューティング (HPC)
- イーサネットスイッチ
- 5G/ワイヤレス
- サーバ
- イーサネットSPルーティング

サーマルブリッジテクノロジーはTE Connectivity (TE) の最新開発技術で、ギャップパッドやサーマルパッドなどの従来の放熱テクノロジーに比べて最大2倍の熱抵抗を実現します。このソリューションは、増大するシステム電力要件、特に制限のあるエアフロー、液冷方式、冷却プレートによる固定された冷却アプリケーションに対応して、さらなる熱伝導を実現すべく開発されました。

市場における各種放熱ソリューションに比べて優れた放熱特性を備えるほか、サーマルブリッジテクノロジーは弾性圧縮により、経時的な弛緩または硬化に耐性があります。この柔軟な圧縮構造によって、より高い信頼性を備えています。これは一定した性能の持続を実現し、動作時におけるコンポーネントの交換回数を減らします。

技術特性および利点

- スプリング内蔵ブリッジは、z軸方向に1.0mm (典型値)の圧縮が可能
- 個々のプレート動作がx軸方向の表面一貫性を保持
- デュアルスプリング機構によりy軸方向の傾きにも対応
- プレート毎の3点接触により、通常のブリッジでは隣接面に対する150点以上の接点を保有
- ドライ抵抗値は、従来の上乗せヒートシンクより20-40%減少

製品仕様

- ドキュメント #:108-130042

アプリケーション仕様

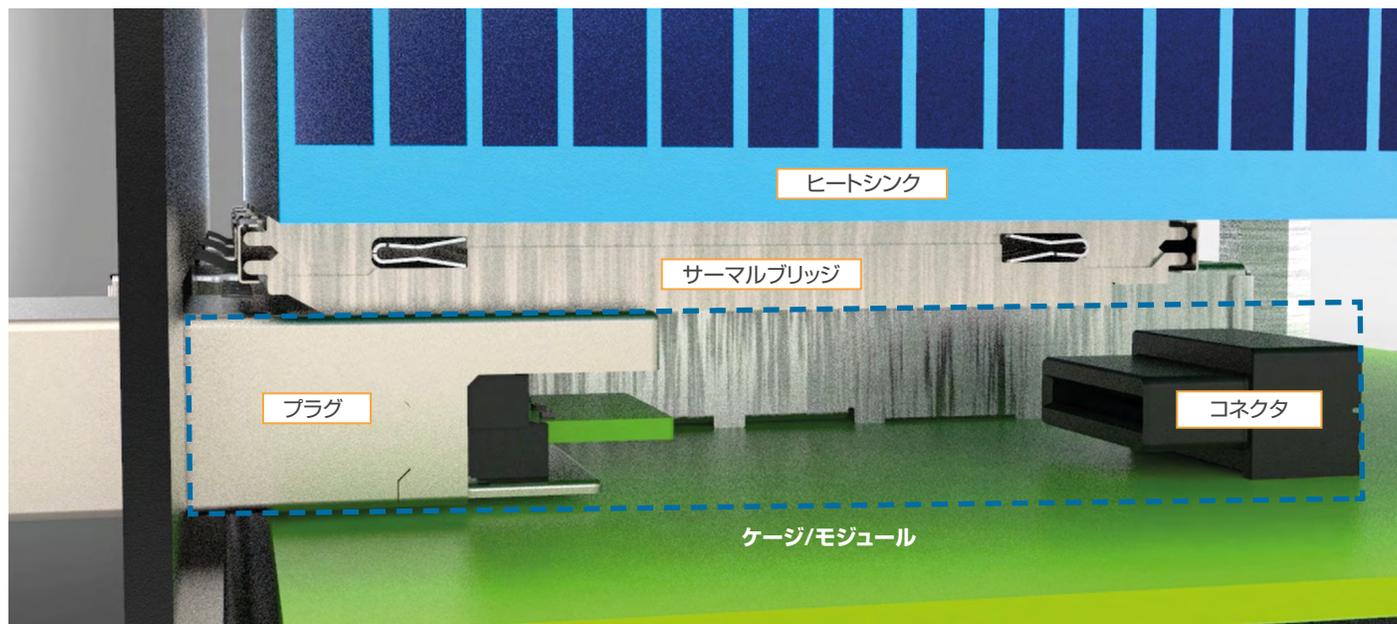
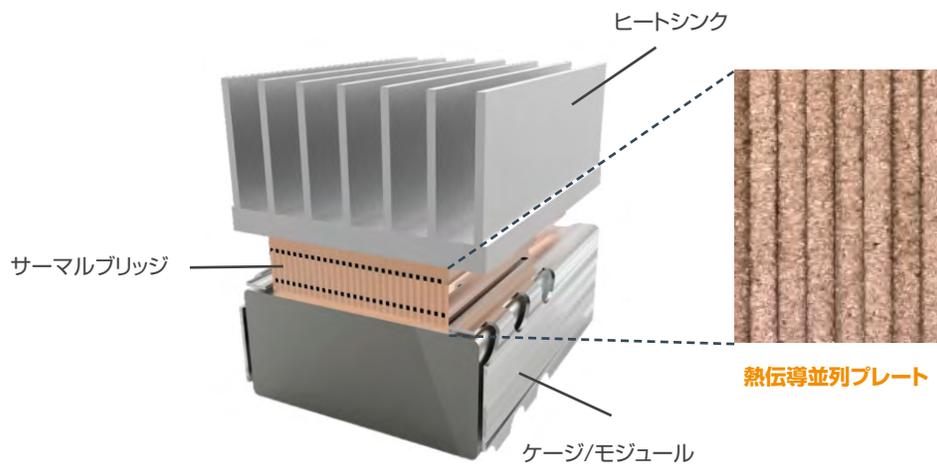
- 各パーツ番号に対する仕様文書を参照 (3ページを参照)

サーマルブリッジテクノロジー

入出力 (I/O) アプリケーション

サーマルブリッジの動作原理

- 高密度で並列して出入りするプレートにより、I/Oモジュールから冷却エリアへ熱が伝達されます
- 内蔵のスプリング機構により、インタフェース応力および圧縮長さ1.0mmの行程が実現します。
- プレートギャップがほぼなく、圧縮機能および熱伝導に対応
- I/Oケージ上に組込済み
- インタフェースには注油可能(オプション)



サーマルブリッジテクノロジー

入出力 (I/O) アプリケーション

サーマルブリッジ併用可能なケージアセンブリ

TEパーツ番号	フォームファクタ	構成	画像
2358986-1	SFP+	1x1	
2354751-1	QSFP-DD	1x1	
2359309-1	QSFP28	1x1	
2354935-1	QSFP28	1x4	
2355519-1	QSFP28	1x6	

カスタム設計オプションについてはTEにお問い合わせください。

te.com

TE Connectivity, TE Connectivity (ロゴ)およびEVERY CONNECTION COUNTSは、TE Connectivity 系列会社の所有またはライセンス保有の商標です。記載されたその他の製品、ロゴ、会社名は対応する各社の所有する商標です。

図、イラスト、回路図を含む記載情報は例示のみを目的とし、信頼性を期しています。しかしながら、TE Connectivity は記載の正確性や完全性への保証は行わず、使用に関する責任は一切負いかねます。TE Connectivityの義務は、TE Connectivityの当製品に対する基本販売契約のみに基づいており、製品販売、再販、使用、誤用を発端とした、その他の偶発的、間接的、または結果として生じた損害に対して、TE Connectivityは責任を一切負いかねます。TE Connectivity製品のユーザー各位が、特定のアプリケーションに対する各製品の適用性を考量されるものといたします。

© 2021 TE Connectivity Ltd. 系列会社 版權所有。

10/21 9-1773982-4 オリジナル

TE Technicalサポートセンター

USA (米国): 1.800.522.6752

カナダ: 1.905.475.6222

メキシコ: 52.0.55.1106.0800

南米米国: 54.0.11.4733.2200

ドイツ: 49.0.6251.133.1999

英国: 44.0.800.267666

フランス: 33.0.1.3420.8686

オランダ: 31.0.73.6246.999

中国: 86.0.400.820.6015